

苏州晶方半导体科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司于 2020 年 1 月 2 日、3 日、6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

● 公司于 2019 年 12 月 31 日召开四届三次临时董事会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准，能否获得通过和批准存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

● 经公司自查并向公司第一大股东征询确认，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 经公司自查，除已披露的非公开发行 A 股股票预案相关事项外，未发现应披露而未披露的重大风险事项。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票于 2020 年 1 月 2 日、3 日、6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司目前生产经营情况正常有序，所处市场环境和行业政策稳定，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

2019年12月31日公司第四届董事会第三临时次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟计划非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过45,935,891股（含），非公开发行股票募集资金总额不超过140,226.00万元，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额全部用于集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换，具体详情详见公司发布的《苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》公告。

上述非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准，能否获得通过和批准存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

除上述事项外，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司。公司、公司第一大股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。公司不存在其他对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2020 年 1 月 2 日、3 日、6 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

截至 2020 年 1 月 6 日收盘，公司静态市盈率为 162.95，根据中国证监会发布的行业分类结果，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造业的平均静态市盈率为 95.43，公司静态市盈率高于行业平均水平。

截止 2020 年 1 月 6 日收盘，公司 TTM 市盈率为 125.11，根据中国证监会发布的行业分类结果，公司所处计算机、通信和其他电子设备制造业的平均 TTM 市盈率为 58.04，公司 TTM 市盈率高于行业平均水平。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

公司生产经营正常有序，无生产经营风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司无媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

（四）重大事项进展风险

公司于 2019 年 12 月 31 日召开四届三次临时董事会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。非公开发行股票相关事项尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准，能否获得通过和批准存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

公司、公司第一大股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（五）行业风险

公司属于集成电路行业，集成电路产业的发展受国际贸易环境与产业周期因素的影响，如果国际环境与产业周期发生不利变化，将对行业发展带来相应的不利影响，敬请投资者关注此行业特征风险。

（六）第一大股东股权质押风险或商誉减值风险。

公司第一大股东中新苏州工业园区创业投资有限公司持有公司 55,048,276 股股份，占公司总股本的 23.97%。截止本公告日，其将所持公司的 28,700,000 股股份进行了质押，占其所持公司股份总数的比例为 52.14%。中新苏州工业园区创业投资有限公司将所持公司部分股份进行质押系其自身经营情况所需，不存在股权质押风险。

公司资产结构中不存在商誉，不存在商誉减值风险。

四、董事会声明及相关方承诺

（一）公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）公司及第一大股东等相关方，目前未筹划涉及上市公司的重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 6 日